



第75回半導体・集積回路技術シンポジウム

開催日：2011年7月7日(木)、8日(金)

会場：早稲田大学 西早稲田キャンパス(旧大久保キャンパス) 55号館N棟1階大会議室

〒169-8555 東京都新宿区大久保3-4-1 (地下鉄副都心線 西早稲田駅3番出口直結)

主催：電気化学会電子材料委員会

協賛：応用物理学会、エレクトロニクス実装学会、高分子学会、精密工学会、電気学会、電子情報通信学会、日本印刷学会、日本化学会、日本金属学会、日本セラミクス協会、日本写真学会、日本表面科学会、日本真空協会

プログラム <シンポジウムテーマ：元気になる半導体>

◇ 第1日 ◇ 7月7日(木) 9:55~17:50
<9:55> 開会の挨拶 電子材料委員会委員長

◇ 第2日 ◇ 7月8日(金) 10:00~17:45

オープニングセッション：世界の半導体産業の展望

<10:00~10:40>

1. 特別講演 タイトル未定

TSMC 小野寺誠

セッション1：More than Moore を超えて

<10:40~11:20>

2. Ge CMOS の可能性と課題

東大 鳥海 明

<11:20~12:00>

3. 超低電圧デバイス技術研究組合における低電圧デバイス開発

LEAP 木村紳一郎、杉井寿博、長永隆志、高浦則克
波田博光、酒井忠司、杉井信之、住広直孝

<12:00~12:40>

4. 近接場ワイヤレス通信が拓く3次元 LSI

慶大 黒田忠広

<12:40~13:40>

昼食

特別セッション：スパコンで世界一を目指す

<13:40~14:20>

5. 特別講演 SPARC64 プロセッサ開発の歴史と今後の展望

富士通 丸山拓巳

セッション2：三次元デバイス(1)

<14:20~15:00>

6. 三次元集積化技術の開発動向と「ドリームチッププロジェクト」の研究開発成果 2010

ASET 嘉田守宏

<15:00~15:40>

7. パンプレス TSV および WOW を用いた三次元集積化技術

東大 大場隆之

<15:40~16:00>

休憩

セッション3：三次元デバイス(2)

<16:00~16:40>

8. True3次元貫通配線

フジクラ 山本 敏、脇岡寛之、額賀 理
菊川直博、松丸幸平、末益龍夫

<16:40~17:20>

9. 高密度実装に貢献するめっき技術

関東学院大 小岩一郎

<17:20~17:50>

10. プラズマドーピングのメカニズムと Fin FET 向けアプリケーション

¹SEN、²住友重工 布施玄秀¹、杉谷道朗¹、室岡博樹¹
栗山 仁²、田中 勝²

<18:10~20:10>

懇親会

セッション4：グリーンデバイス

<10:00~10:40>

11. 次世代エネルギーシステムと技術開発

AIST 安芸裕久

<10:40~11:20>

12. 超低消費電力 LSI 向けシリコンナノワイヤトランジスタの高性能化技術

¹東芝、²東工大 齋藤真澄¹、中林幸雄¹
太田健介¹、内田 建²、沼田敏典¹

<11:20~12:00>

13. SiCパワーデバイス

三菱電機 古川彰彦、今泉昌之、大森達夫

<12:00~12:40>

14. Si基板を利用したGaN系パワー素子

富士通

<12:40~13:40>

昼食

特別セッション：世界の半導体産業の展望

<13:40~14:20>

15. 特別講演 Game Changer

Intel 阿部剛士

セッション5：バイオ・有機デバイス(1)

<14:20~15:00>

16. 機能化ナノ構造ゲートバイオトランジスタ

東京医科歯科大 松元 亮、宮原裕二

<15:00~15:40>

17. 高移動度有機半導体材料の開発

広島大 瀧宮和男

<15:40~16:00>

休憩

セッション6：バイオ・有機デバイス(2)

<16:00~16:40>

18. 高精細印刷技術を用いたフレキシデバイス

東大 関谷 毅、染谷隆夫

<16:40~17:20>

19. 機能性デイト絶縁層を用いた不揮発性有機メモリー

北陸先端大 村田英幸、矢島 寛、今野広大、酒井平祐

セッション7：先端CMOS技術

<17:20~17:45>

20. 高速ロジック混載DRAMに向けた多孔質Low-k膜層への

シリンドラMIM容量形成技術

ルネサスエレクトロニクス 脇岡 健一郎、井上尚也、久米一平
川原 潤、古武直也、齋藤 忍、山本博規、長谷 卓、林 喜宏

<17:45> 閉会の挨拶

プログラム委員長

本シンポジウムは、わが国の半導体・集積回路技術に関する特色ある講演会として発足し、この度第75回を迎えることとなりました。今回のシンポジウムの開催に当たっては、メインテーマを“元気が出る半導体”とし、特別セッション、及び先端CMOS技術、More than Moore技術、三次元デバイス技術、グリーンデバイス技術、バイオ・有機デバイス技術等に関するセッションを設けました。シリコンLSIの研究・開発・事業に従事する方々に活発な討論の場を提供致します。

参加登録費（講演論文集1部，懇親会費を含む）

事前 会員19,000円 会員外21,000円 大学関係5,000円 学生2,500円（1日のみ 会員13,000円 会員外14,000円）

当日 会員22,000円 会員外24,000円 大学関係6,000円 学生3,000円（1日のみ 会員15,000円 会員外16,000円）

事前参加申込み方法： e-mailにて事務局までお申し出ください。参加費用は現金書留または銀行振込にて**7月1日(金)**迄にお支払い下さい。振込先：みずほ銀行大岡山支店普通預金口座1926159 電子材料委員会小田俊理 オダシュンリ。

参加申込先（e-mail可）

〒102-0074 東京都千代田区九段南 4-8-30 アルス市ヶ谷202 電気化学会電子材料委員会事務局

(TEL: 03-3234-4213, FAX: 03-3234-3599, e-mail: kayama@electrochem.jp)

本シンポジウムに関する詳細はホームページ(<http://semicon.electrochem.jp/>)にも掲載しています。

<シンポジウム会場ご案内>

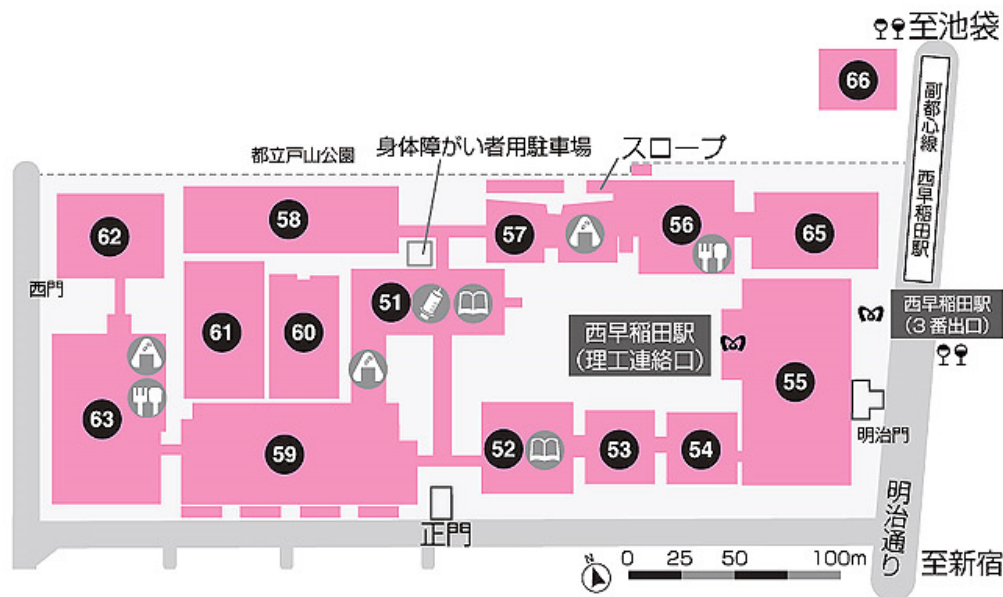
早稲田大学 西早稲田キャンパス(旧大久保キャンパス) 55号館N棟1階大会議室

〒169-8555 東京都新宿区大久保3-4-1

<http://www.waseda.jp/jp/campus/okubo.html>

交通：地下鉄副都心線 西早稲田駅3番出口直結

早稲田大学学内地図



電気化学会電子材料委員会／委員長：嶋 昇平(荏原製作所)、副委員長：本間敬之(早稲田大)、副委員長：小林清輝(東海大)、幹事：柏木勇作(東京エレクトロン)、委員：市川弘之(住友電工)、金岡竜範(ルネサスエレクトロニクス)、北野尚武(キャノンアネルバ)、久保高行(SUMCO)、久保田正文(パナソニック)、近藤英一(山梨大)、寒川誠二(東北大)、新宮原正三(関西大)、高浦則克(日立製作所)、谷口研二(大阪大)、三島康由(富士フイルム)、靱山陽一(富士通セミコンダクター)、脇屋和正(東京応化工業)、渡邊桂(東芝)、海外委員：吉田 誠 (Samsung)、顧問：小田俊理(東工大)、顧問：須田良幸(東京農工大)

第75回半導体・集積回路技術シンポジウム プログラム委員会／委員長：近藤英一(山梨大)、委員：金岡竜範(ルネサスエレクトロニクス)、渡邊桂(東芝)、北野尚武(キャノンアネルバ)、柏木勇作(東京エレクトロン)

第75回半導体集積回路技術シンポジウム参加予約申込書様式

(参加申込先：電気化学会電子材料委員会、〒102-0074東京都千代田区九段南4-8-30アルス市ヶ谷202)
(TEL:03-3234-4213, FAX:03-3234-3599, kayama@electrochem.jp)

☆申し込みはE-mailまたはFAXでお願いします。

氏名	
勤務先	(部所)
住所	〒 TEL: E-mail:
会員資格	<input type="checkbox"/> 会員 (電気化学会・協賛学協会会員) <input type="checkbox"/> 会員外 <input type="checkbox"/> 大学関係 <input type="checkbox"/> 学生
参加日数	<input type="checkbox"/> 2日通し参加 <input type="checkbox"/> 1日のみ参加 (<input type="checkbox"/> 7月7日 <input type="checkbox"/> 7月8日)
参加費の 支払い	<input type="checkbox"/> 現金同封 <input type="checkbox"/> 銀行振り込み 月 日 振り込み予定